

## 「実装技術セミナー」報告

節目となる第 50 回 YJC 実装技術セミナーは、2019 年 11 月 28 日（木）に開催しました。今回は、発展著しい AI に関して AI とは何であるか、またその産業界への展開はどうできるのかなどをわかりやすく探るセミナー内容で、長尾智晴先生（横浜国立大学）には AI の今後の展開について、白石洋一先生（群馬大学）には AI の最新応用例について、永田基樹氏（株式会社 plus zero）には AI とは何であるかについて、それぞれ分かりやすくご講演をいただきました。さらに入江満氏（MI-6 株式会社）には AI を用いて材料開発期間を驚異的に短縮する方法を紹介して頂き、参加者 37 名の中から質疑応答も活発で講演後の交流会でも盛況でありました。

<実装技術セミナー写真>

から基礎も学習するコースとして、レベルアップを目指す実装技術者に向けて 13 年以上の実績を持つ講座で、前回好評であった講義と見学をセットにした形態で実施します。

1 日目は 3 月 10 日「株式会社メイコー（配線基板トップメーカー）」で開催し、工場見学と大久保利一氏（NPO 法人 サーキット・ネットワーク）の「実装基板の変遷～プリント配線板から半導体パッケージさらにはシステムインパッケージへ」のテーマでの講義です。2 日目は 3 月 17 日「シークスエレクトロニクス株式会社（大手 EMS メーカー）」で開催し、工場見学と津田建二氏（株）セミコンダクタポータル、国際技術ジャーナリスト）の「デジタル新時代の潮流と実装技術」のテーマで講義を予定しています。各先着 20 名の定員ですので早めの申し込みをお待ちしています。

<JISSO スクールパンフレット>



YJC 技術セミナー風景 1



YJC 技術セミナー風景 2



活発な質疑応答



歓談風景

(佐脇)

## 「実装スクール」予告

我々の身の回りを取り巻く技術の潮流は AI（人工知能：Artificial Intelligence）、IoT（モノのインターネット：Internet of Things）、5G 通信（第 5 世代通信：5th generation）など、大変革が急速に進んでいます。この変化に対して、実装技術の潮流を知り、また現場見学

レベルアップを目指す実装技術者のために  
よこはま高度実装技術コンソーシアム(YJC)の実力派実装技術者育成プログラム

**JISSO スクール 2020** (2019年度開講分)  
プリント配線板、部品実装学習コース  
プリント配線板、部品実装の工場見学と最近の実装の潮流を学習

- 主催 よこはま高度実装技術コンソーシアム (YJC)
- 協賛 国立大学法人 横浜国立大学 (予定)  
 特定非営利活動法人 サーキットネットワーク (C-NET)  
 一般社団法人 エレクトロニクス実装学会 (JIEP) (予定)  
 公益社団法人 化学工学会 エレクトロニクス部会
- 運営担当 特定非営利活動法人 ユーベック (YUVEC)

私たちを取り巻く世界の技術はAI、IoT、これらを支える5G通信など大変革が急速に進んでいます。この変化に対してエレクトロニクス実装技術の潮流を知り、また現場見学から実装の基礎も学習するコースです。

- 開講日: 第1回: 2020年3月10日(火) 第2回 3月17日(火) 2日間
- 会場: 第1回: 株式会社メイコー(横浜上大5-14-15)  
第2回: シークスエレクトロニクス株式会社(相模原市緑区町屋1-3-25)
- 参加費: 2回とも参加 3万6000円 どちらか1回のみ参加 (1日単位) 2万円/日 但しYJC法人会員、正会員、JIEP会員、C-NET会員、化学工学会会員は2割引き
- 申込み: 裏面に所定事項をご記入の上FAXあるいはメールにて
- 募集人数: 各回20名
- 申し込み締め切り: 第1回 3月3日(火) 第2回 3月10日(火)  
ただし定員に達し次第締め切りとさせていただきます。

日程と時間割

月日	会場	時間	内容	講師(敬称略)	講師所属
2020年 3月10日 (火)	株式会社 メイコー	10:30~12:00	講義 実装基板の変遷～プリント配線板から半導体パッケージさらにはシステムインパッケージへ プリント配線板が多層基板から半導体パッケージ用ビルドアップ基板へ変遷してきた経緯とその中に取り入れられた代表的技術の歴史。さらに5GやAI、IoTの時代に対応したシステムインパッケージの動向	大久保 有一氏	特定非営利活動法人 サーキットネットワーク
		13:00~14:30	講義 プリント配線板製造プロセス、メイコーの取り組み	紅谷 一寛氏	メイコー
		14:40~16:10	見学 神奈川工場プリント配線板製造現場見学と質疑応答	各部署担当者	メイコー
2020年 3月17日 (火)	シークス エレクト ロニクス 株式会社	10:30~12:00	講義 デジタル新時代の潮流と実装技術 AI、IoT、5Gおよび自律化とセキュリティを中心に実装の話を語り交ぜながら最新のトピックスについて解説	津田 建二氏	株式会社セミコンダクタポータル (国際技術ジャーナリスト)
		13:00~14:30	講義 部品実装プロセス、シークスエレクトロニクス株の取り組み		シークスエレクトロニクス株
		14:40~16:10	見学 部品実装ライン現場見学と質疑応答		シークスエレクトロニクス株

各会場へのアクセス、受講時の注意事項などは受講申し込みされた方に後日お知らせいたします。

よこはま高度実装技術コンソーシアム(企画・運営 特定非営利活動法人YUVEC)  
横浜市保土ヶ谷区常盤台79-5 横浜国立大学共同研究推進センター1F TEL:045-340-3981(担当:佐脇)

(佐脇)